

中国芯片设计行业发展深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国芯片设计行业发展深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202411/733364.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

芯片设计又被称为电路设计，是指以集成电路，超大规模集成电路为目标的设计流程。

我国芯片设计行业相关政策

为推动芯片的研发和创新，我国发布了一系列行业政策，如2024年工业和信息化部办公厅发布的《关于开展2024年度5G轻量化（RedCap）贯通行动的通知》提出鼓励芯片企业加强技术攻关，完成不少于3款芯片研发并推进产业化。组织开展5G RedCap芯片的协议一致性和网络兼容性测试，不断提升芯片性能。

2023-2024年我国芯片设计行业部分相关政策情况

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2023年3月	国家能源局	关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见	加快推动能源领域工控系统、芯片、操作系统、通用基础软硬件等自主可控和安全可靠应用。
2023年4月	工业和信息化部等八部门	关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见	瞄准网络处理器、交换芯片、高速串行接口、可编程逻辑器件、专用软件等产业链关键环节，充分发挥产业链下游用户企业的需求牵引作用，加强全链条协同联动，补齐产业链短板，不断提升产业链安全水平。

2023年8月	工业和信息化部、财政部	电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案	全面提升供给能力。落实《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》及各项细则，落实集成电路企业增值税加计抵减政策，协调解决企业在享受优惠政策中的问题。着力提升芯片供给能力，积极协调芯片企业与应用企业的对接交流。
---------	-------------	--------------------------	---

2023年9月	市场监管总局	关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见	重点突破极端量、复杂量、微量或复杂应用环境下的高准确度测量难题，探索开展量子芯片、物联网、大数据、人工智能、数字孪生等技术在仪器仪表产业中的应用，解决关键环节受制于人的技术难题。
---------	--------	------------------------	---

2023年10月	工业和信息化部办公厅	关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知	推动产业链上下游协同联动，推进5G RedCap芯片、模组、终端、网络、仪表等产品研发和产业化，加快RedCap与网络切片、高精度定位、5G
----------	------------	---------------------------------	--

2023年10月	国家发展改革委、国家能源局	关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见	提高电力工控芯片、基础软件、关键材料和元器件的自主可控水平，强化电力产业链竞争力和抗风险能力。
----------	---------------	-----------------------	---

2024年2月	工业和信息化部等七部门	关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见	在新一代信息技术领域，引导数据中心扩大绿色能源利用比例，推动低功耗芯片等技术产品应用，探索构建市场导向的绿色低碳算力应用体系。
---------	-------------	---------------------	---

市场监管总局、中央网信办等部门

2024年3月	国家知识产权局	贯彻实施 国家标准化发展纲要 行动计划（2024—2025年）	健全产业基础标准体系。制修订精密减速器、高端轴承、车规级汽车芯片等核心基础零部件（元器件）共性技术标准，推动解决产品高性能、高可靠性、长寿命等关键问题。
---------	---------	---------------------------------	--

推动知识产权高质量发展年度工作指引（2024） 聚焦数字化、绿色化发展，开展人工智能、高端芯片、量子信息等关键数字技术及绿色技术专利统计分析，发布2024年中英文版全球绿色低碳技术专利统计分析报告。 2024年4月 工业和信息化部办公厅

关于开展2024年度5G轻量化（RedCap）贯通行动的通知

鼓励芯片企业加强技术攻关，完成不少于3款芯片研发并推进产业化。组织开展5G

RedCap芯片的协议一致性和网络兼容性测试，不断提升芯片性能。 2024年8月

工业和信息化部办公厅 关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知

鼓励芯片、模组企业加快技术创新和产业化。 2024年10月 农业农村部

关于大力发展智慧农业的指导意见 加快技术装备研发攻关。根据轻重缓急建立重大问题清单,加快农业传感器与专用芯片、农业核心算法、农业机器人等关键核心技术研发攻关,深入推进人工智能大模型、大数据分析等技术在农业农村领域融合应用。

资料来源：观研天下整理

部分省市芯片设计行业相关政策

我国各省市也积极响应国家政策规划,对各省市芯片设计行业的发展做出了具体规划,支持当地芯片设计行业稳定发展，比如上海市发布的《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024-2027年）》提出提升工业企业数据互通效能，实施“工赋链主专项工程”，在芯片、汽车等领域建设行业级工业互联网平台，开展数据挖掘、采集和分析，打通产能、订单、库存、生产制造数据。

2023-2024年部分省市芯片设计行业相关政策情况 发布时间 省市 政策名称 主要内容
2023年2月 江苏省 关于推动战略性新兴产业融合集群发展的实施方案 巩固先进封装领域优势，建设大规模特色工艺制程和先进工艺制程生产线，提升集成电路设计工具供给能力，突破高端芯片设计、核心装备及材料器件等关键环节，力争在新一代微电子与光电子芯片领域抢得先发优势，有效提升集成电路装备与材料国产化配套能力。 2023年3月 湖南省
湖南省“智赋万企”行动方案（2023—2025年） 通过“十大技术攻关”“揭榜挂帅”等方式，加大新一代半导体、新型显示、基础电子元器件、关键软件、人工智能、大数据、先进计算、高性能芯片、智能传感等重点领域核心技术创新力度，提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料供给水平，突破数字孪生、边缘计算、区块链、智能制造等集成技术。

建设创新主体。 2023年3月 吉林省 关于支持电子信息制造业创新发展的意见 集聚优质创新资源，组织实施核心光电子器件和高端芯片重大科技专项，加快攻克半导体激光雷达、面发射激光器、忆阻器等重要领域“卡脖子”技术；实施一批重点研发计划项目，提升一批优势技术和产品研发能力，引领支撑产业基础高级化和产业链现代化。 2023年6月 江西省

江西省制造业数字化转型实施方案 强化人工智能技术应用，发展智能硬件产品，加快智能传感终端、高端芯片、通用处理器等领域研发突破和迭代应用。 2023年6月 河南省

河南省实施扩大内需战略三年行动方案（2023—2025年） 加快推动数字化转型。培育壮大先进计算、物联网、网络安全等优势产业，推进超聚变全球总部、海康威视郑州智能制造基

地、信大捷安标识认证安全芯片等重大项目建设，加快建设郑州国家新一代人工智能创新发展试验区，力争到2025年数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重比2020年提高2.5个百分点。2023年7月 山西省 关于促进企业技术改造的实施意见 半导体产业加强材料、装备、芯片、封装等领域布局，发展集成电路、光电器件、分立器件、传感器等产品，推动碳化硅衬底材料规模化生产。2023年8月 宁夏回族自治区 促进人工智能创新发展政策措施 积极引进国内服务器制造龙头企业，发挥其在供应链的优势，整合数字产业生态资源，重点推动服务器制造、基础芯片的产学研及配套产业建设，吸引更多算力设施企业加入，培育算力设施规模化、集群化，带动建立服务器及其核心部件的制造链，打造本地化产业生态。

2023年9月 河北省 关于促进电子信息产业高质量发展的意见 实施先进制造业集群发展专项行动，围绕集成电路等战略性领域，建立京津冀协同培育机制，强化区域联动和政策协同，加强产业链供应链协作，培育集基础材料、芯片设计、工艺制造、封装测试于一体的集成电路先进制造业集群。

2023年11月

山东省

山东省数字基础设施建设行动方案（2024-2025年）集中攻关网络通信芯片、物联网操作系统等关键技术，培育壮大济南、青岛、烟台、潍坊等物联网产业基地，加快打造物联网应用场景，推动部署千万级感知节点。

2023年9月

北京市

北京市促进未来产业创新发展实施方案 开展6G网络架构、太赫兹通信、网络覆盖扩展与天地融合、芯片以及配套软硬件、测试仪器仪表等关键核心技术攻关。搭建应用标准规范研制协作网络，抢占全球专利和标准创新高地。打造网络与应用融合试验平台，前瞻探索布局典型应用场景。

2023年11月

北京市

北京市关于贯彻落实 制造业可靠性提升实施意见 的实施方案 重点提升工业母机用大功率激光器、工业机器人用精密减速器、仪器仪表用传感器、电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、车规级汽车芯片等关键核心基础零部件的可靠性水平。

2024年2月

安徽省 关于巩固和增强经济回升向好态势若干政策举措 重点围绕轻量化材料、车规级芯片、下一代动力电池、新型充换电技术、智能驾驶体系等关键领域，支持组建创新联合体，最高可按研发和设备投入的50%予以补助。

2024年5月

广东省

广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施 建立人工智能芯片生态体系。建设适配芯片的开发生态，面向家电家居、安防监控、医疗设备等，加大高性能、低功耗的端侧芯片开发生产。鼓励企业通过集成处理器、射频通信、智能传感器、存储器等，推进通信、显示、音频等模组研发。培育芯片创新发展生态，探索存算一体、类脑计算、芯粒、指令集等芯片研发与应用，推动面向云端和终端的芯片应用，推广高性能云端智能服务器。到2027年，人工智能芯片生态体系初步建成。

2023年9月

天津市

天津市加快新能源和智能网联汽车产业发展实施方案（2023—2027年）

加快发展车规级芯片。加大车规级微控制单元（MCU）芯片、射频芯片、视频传输芯片研发力度，实现射频芯片国产替代，在汽车安全和车联网通信安全方面形成领先优势。成立中国汽车芯片标准检测服务联盟，打造汽车芯片标准体系和汽车芯片测试认证评价体系。争取

汽车芯片链主央企在津布局，打造滨海新区车规级芯片产业集群，鼓励整车企业开放汽车芯片应用场景。2024年7月 天津市 天津市算力产业发展实施方案（2024—2026年）提升关键技术创新能力。聚焦突破“卡脖子”技术，支持企业加快人工智能（AI）芯片布局，推进国产化中央处理器（CPU）、深度计算处理器（DCU）、数据处理器（DPU）、神经网络处理器（NPU）等算力核心芯片技术路线整合和产品迭代。 2023年12月 上海市
上海市促进在线新经济健康发展的若干政策措施
支持打造智能芯片软硬件适配体系，降低企业适配成本。 2024年7月 上海市
上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024-2027年）提升工业企业数据互通效能。实施“工赋链主专项工程”，在芯片、汽车等领域建设行业级工业互联网平台，开展数据挖掘、采集和分析，打通产能、订单、库存、生产制造数据。 2024年9月 上海市
上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案 推进金融业信息化核心技术安全可控。聚焦信创发展趋势，支持芯片、操作系统、数据库等领域核心技术创新，加快构建自主可控的金融领域信息技术创新生态体系，持续提升金融关键软硬件国产化替代水平和应用规模。
资料来源：观研天下整理（XD）

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。更多图表和内容详见报告正文。

观研报告网发布的《中国芯片设计行业发展深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。

本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。

本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国芯片设计行业发展概述

第一节 芯片设计行业发展情况概述

- 一、芯片设计行业相关定义
- 二、芯片设计特点分析
- 三、芯片设计行业基本情况介绍
- 四、芯片设计行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售/服务模式
- 五、芯片设计行业需求主体分析

第二节 中国芯片设计行业生命周期分析

- 一、芯片设计行业生命周期理论概述
- 二、芯片设计行业所属的生命周期分析

第三节 芯片设计行业经济指标分析

- 一、芯片设计行业的赢利性分析
- 二、芯片设计行业的经济周期分析
- 三、芯片设计行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球芯片设计行业市场发展现状分析

第一节 全球芯片设计行业发展历程回顾

第二节 全球芯片设计行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲芯片设计行业地区市场分析

- 一、亚洲芯片设计行业市场现状分析
- 二、亚洲芯片设计行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲芯片设计行业市场前景分析

第四节 北美芯片设计行业地区市场分析

- 一、北美芯片设计行业市场现状分析
- 二、北美芯片设计行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美芯片设计行业市场前景分析

第五节 欧洲芯片设计行业地区市场分析

- 一、欧洲芯片设计行业市场现状分析
- 二、欧洲芯片设计行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧洲芯片设计行业市场前景分析

第六节 2024-2031年世界芯片设计行业分布走势预测

第七节 2024-2031年全球芯片设计行业市场规模预测

第三章 中国芯片设计行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

第二节我国宏观经济环境对芯片设计行业的影响分析

第三节中国芯片设计行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节政策环境对芯片设计行业的影响分析

第五节中国芯片设计行业产业社会环境分析

第四章 中国芯片设计行业运行情况

第一节中国芯片设计行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节中国芯片设计行业市场规模分析

一、影响中国芯片设计行业市场规模的因素

二、中国芯片设计行业市场规模

三、中国芯片设计行业市场规模解析

第三节中国芯片设计行业供应情况分析

一、中国芯片设计行业供应规模

二、中国芯片设计行业供应特点

第四节中国芯片设计行业需求情况分析

一、中国芯片设计行业需求规模

二、中国芯片设计行业需求特点

第五节中国芯片设计行业供需平衡分析

第五章 中国芯片设计行业产业链和细分市场分析

第一节中国芯片设计行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、芯片设计行业产业链图解

第二节中国芯片设计行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对芯片设计行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对芯片设计行业的影响分析

第三节我国芯片设计行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国芯片设计行业市场竞争分析

第一节中国芯片设计行业竞争现状分析

一、中国芯片设计行业竞争格局分析

二、中国芯片设计行业主要品牌分析

第二节中国芯片设计行业集中度分析

一、中国芯片设计行业市场集中度影响因素分析

二、中国芯片设计行业市场集中度分析

第三节中国芯片设计行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国芯片设计行业模型分析

第一节中国芯片设计行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节中国芯片设计行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国芯片设计行业SWOT分析结论

第三节中国芯片设计行业竞争环境分析（PEST）

- 一、PEST模型概述
- 二、政策因素
- 三、经济因素
- 四、社会因素
- 五、技术因素
- 六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国芯片设计行业需求特点与动态分析

第一节中国芯片设计行业市场动态情况

第二节中国芯片设计行业消费市场特点分析

- 一、需求偏好
- 二、价格偏好
- 三、品牌偏好
- 四、其他偏好

第三节芯片设计行业成本结构分析

第四节芯片设计行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、其他因素

第五节中国芯片设计行业价格现状分析

第六节中国芯片设计行业平均价格走势预测

- 一、中国芯片设计行业平均价格趋势分析
- 二、中国芯片设计行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国芯片设计行业所属行业运行数据监测

第一节中国芯片设计行业所属行业总体规模分析

- 一、企业数量结构分析
- 二、行业资产规模分析

第二节中国芯片设计行业所属行业产销与费用分析

- 一、流动资产
- 二、销售收入分析
- 三、负债分析
- 四、利润规模分析
- 五、产值分析

第三节中国芯片设计行业所属行业财务指标分析

- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国芯片设计行业区域市场现状分析

第一节中国芯片设计行业区域市场规模分析

- 一、影响芯片设计行业区域市场分布的因素
- 二、中国芯片设计行业区域市场分布

第二节中国华东地区芯片设计行业市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区芯片设计行业市场分析
 - (1) 华东地区芯片设计行业市场规模
 - (2) 华东地区芯片设计行业市场现状
 - (3) 华东地区芯片设计行业市场规模预测

第三节华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区芯片设计行业市场分析
 - (1) 华中地区芯片设计行业市场规模
 - (2) 华中地区芯片设计行业市场现状
 - (3) 华中地区芯片设计行业市场规模预测

第四节华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区芯片设计行业市场分析
 - (1) 华南地区芯片设计行业市场规模
 - (2) 华南地区芯片设计行业市场现状
 - (3) 华南地区芯片设计行业市场规模预测

第五节华北地区芯片设计行业市场分析

- 一、华北地区概述
- 二、华北地区经济环境分析
- 三、华北地区芯片设计行业市场分析

- (1) 华北地区芯片设计行业市场规模
- (2) 华北地区芯片设计行业市场现状
- (3) 华北地区芯片设计行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

- 一、东北地区概述
- 二、东北地区经济环境分析
- 三、东北地区芯片设计行业市场分析
 - (1) 东北地区芯片设计行业市场规模
 - (2) 东北地区芯片设计行业市场现状
 - (3) 东北地区芯片设计行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

- 一、西南地区概述
- 二、西南地区经济环境分析
- 三、西南地区芯片设计行业市场分析
 - (1) 西南地区芯片设计行业市场规模
 - (2) 西南地区芯片设计行业市场现状
 - (3) 西南地区芯片设计行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

- 一、西北地区概述
- 二、西北地区经济环境分析
- 三、西北地区芯片设计行业市场分析
 - (1) 西北地区芯片设计行业市场规模
 - (2) 西北地区芯片设计行业市场现状
 - (3) 西北地区芯片设计行业市场规模预测

第十一章 芯片设计行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
 - 1、主要经济指标情况
 - 2、企业盈利能力分析
 - 3、企业偿债能力分析
 - 4、企业运营能力分析
 - 5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第七节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第八节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十二章 2024-2031年中国芯片设计行业发展前景分析与预测

第一节中国芯片设计行业未来发展前景分析

一、芯片设计行业国内投资环境分析

二、中国芯片设计行业市场机会分析

三、中国芯片设计行业投资增速预测

第二节中国芯片设计行业未来发展趋势预测

第三节中国芯片设计行业规模发展预测

一、中国芯片设计行业市场规模预测

二、中国芯片设计行业市场规模增速预测

三、中国芯片设计行业产值规模预测

四、中国芯片设计行业产值增速预测

五、中国芯片设计行业供需情况预测

第四节中国芯片设计行业盈利走势预测

第十三章 2024-2031年中国芯片设计行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国芯片设计行业进入壁垒分析

一、芯片设计行业资金壁垒分析

二、芯片设计行业技术壁垒分析

三、芯片设计行业人才壁垒分析

四、芯片设计行业品牌壁垒分析

五、芯片设计行业其他壁垒分析

第二节芯片设计行业风险分析

一、芯片设计行业宏观环境风险

二、芯片设计行业技术风险

三、芯片设计行业竞争风险

四、芯片设计行业其他风险

第三节中国芯片设计行业存在的问题

第四节中国芯片设计行业解决问题的策略分析

第十四章 2024-2031年中国芯片设计行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国芯片设计行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国芯片设计行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节芯片设计行业营销策略分析

一、芯片设计行业产品策略

二、芯片设计行业定价策略

三、芯片设计行业渠道策略

四、芯片设计行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202411/733364.html>